



TE Connectivity(TE) は、日々お客様に革新的な技術とノウハウを提供し、接続技術の将来の発展に寄与できるよう尽力しています。本アプリケーションガイドでは、お客様が抱えるさまざまな課題の解決のお手伝いをするTEの最新製品を紹介致します。

新製品

アプリケーションガイド

2019年10月

携帯用デバイス
.....
スマートホーム
.....
ソリッドステートライティング
.....
インテリジェントビルディング
.....
VA (高付加価値) アセンブリ
.....
ファクトリーオートメーション
.....
データコミュニケーション
.....
過酷な環境向けソリューション
.....
常時接続に必要なパワーを提供
.....



携帯用

デバイス

より持ち運びやすく、また、より小型、軽量、薄型であること、このようなお客様のニーズが、急速に成長するエレクトロニクス産業に於いて一層高まっています。TE は絶え間ない技術革新により、様々な小型インターコネクト製品をラインアップしています。変わりゆく産業のトレンドやニーズに対応する TE の最新製品をぜひご活用ください。



a

a. GNSS アンテナ標準製品 シリーズ

個々のデバイス構成に合わせた幅広いマルチバンドアンテナを使用することにより、ワイヤレス接続による測位の信頼性を高めます。

b. ロック式フレキシブルプリント回路 (FPC) コネクタ

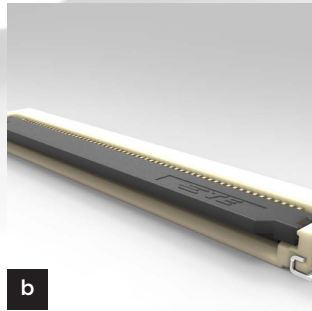
FPC ケーブルをコネクタに固定し、過酷な環境での偶発的な抜けを防ぎます。ZIF (Zero Insertion Force) 設計により、FPC コネクタの摩耗を減らし、嵌合回数を増やします。

c. SpO2 サーフェスマウント型光学コンポーネント

赤色 LED の波長公差が最大 660nm ± 3nm で、高い精度を実現し、正確性を向上します。リフローはんだ付けが可能な設計により、全体的なコストを抑え、品質を高めます。

d. MS5840-02BA 圧力センサ

3.3 × 3.3 × 1.7mm という市場最小クラスの低背型高度計で、スペースを節約できます。超低消費電力で、高精度なデジタル 24 ビットの圧力測定値と温度測定値を実現します。



b

e. 3 in 2 カードコネクタ

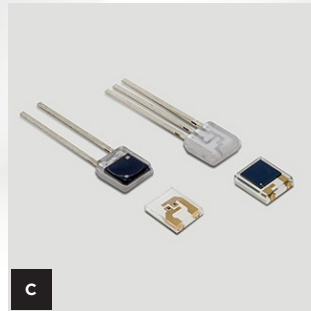
カード挿抜時の損傷を防ぐ堅牢性に優れたソリューションを提供します。2 枚の SIM カード、または 1 枚の SIM カードと 1 枚のマイクロ SD カードを挿入できます。

f. MS5837-02BA 超小型ゲル充填圧力・温度センサ

超低消費電力で、高精度なデジタル 24 ビットの圧力値と温度値を実現します。塩素環境における耐久性を向上します。

g. 低背型フレキシブルプリント回路 (FPC) コネクタ

アクチュエータの堅牢なデザインにより、組み立て中の破損を防ぎます。0.5mm のバックフリップタイプにはデュアルコンタクト設計が採用されており、2 方向でのコネクタとケーブルとの接続が可能です。



c

h. デジタルマイクロミラーデバイス (DMD) 257 ソケット

作業工程中の端子の損傷を防ぎ、チップを確実に取り付けられるアンチフックコンタクト設計を備え、高い信頼性を実現します。

i. 超小型スプリングフィンガ

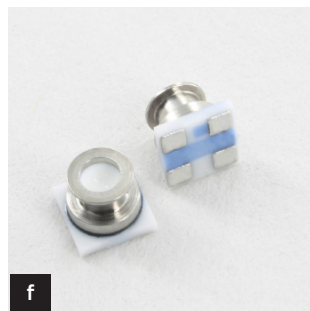
市場最小クラスの設置面積により、PCB のスペースを節約します。クローズループコンタクト設計により、PCB への確実な接続、大電流容量 (1.5A) を実現します。



d



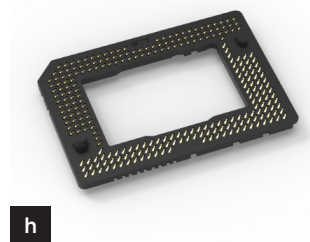
e



f



g



h



i

スマート ホーム

世界的なエンジニアネットワークを持つTEは、お客様のスマートホーム用途のアイデアの実現を支援します。生活家電、照明、HVAC、セキュリティなど、幅広い接続ソリューションとセンサソリューションを持つTEは、お客様の製品の迅速な市場投入を支援する理想的なパートナーです。

a. GNSS アンテナ標準製品シリーズ

個々のデバイス構成に合わせた幅広いマルチバンドアンテナを使用することにより、ワイヤレス接続による測位の信頼性を高めます。

b. ロック式フレキシブルプリント回路 (FPC) コネクタ

FPC ケーブルをコネクタに固定し、過酷な環境での偶発的な抜けを防ぎます。ZIF (Zero Insertion Force) 設計により、FPC コネクタの摩耗を減らし、嵌合回数を増やします。

c. ELCON Micro 電線対基板ソリューション

故意の誤嵌合を防ぐ設計であり、3.0mmの業界標準フットプリントでピンあたり最大 12.5A の高電流を提供します。

d. 低背型フレキシブルプリント回路 (FPC) コネクタ

市場最小クラスの低背型コネクタで、省スペースを実現します。アクチュエータの堅牢なデザインにより、組み立て中の破損を防ぎます。0.5mm のバックフリップタイプにはデュアルコンタクト設計が採用されており、2方向でのコネクタとケーブルの接続が可能です。

e. 防水 (IPX8) USB Type-C リセプタクル

IEC 60529 に準拠した業界トップクラスの IPX8 防水性能を実現します。水分が存在する過酷な環境アプリケーションに最適です。

f. SlimSeal コネクタミニチュアシリーズ

IP67 定格コネクタで、シールドソリューションを実現します。ポジティブラッチ機構により、不慮のコネクタの抜けを防止します。

g. 250 シリーズ Mini FASTON リセプタクル

狭い空間に収まる、ミニチュアサイズのストレート構成を採用しました。標準的な 0.250 x 0.032 インチタブと嵌合します。

h. BUCHANAN WireMate 2 ピースポークインシリーズ

工具を必要としないポークイン電線の結線により、配線が簡単です。ワイヤマーキング用に平らなコネクタ表面を用意しました (カラーオプションあり)。

i. フレックスグリップワイヤコネクタ

すばやく簡単な結線により、取り付け時間を短縮します。柔軟性に優れ、配線の再加工やコネクタの再利用が可能です。

j. AmbiMate センサモジュール開発キット MS4 シリーズ

予め加工されたセンサソリューションを組み込むことによって、市場投入までの時間を短縮します。I²C 通信プロトコルを使用して、AmbiMate センサモジュールを簡単に統合できます。



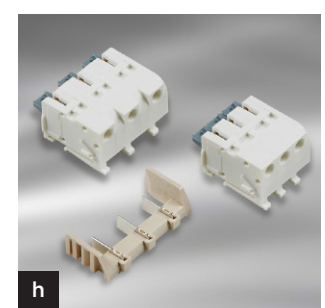
c



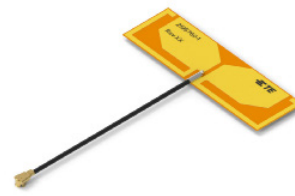
g



d



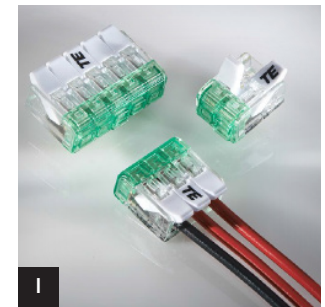
h



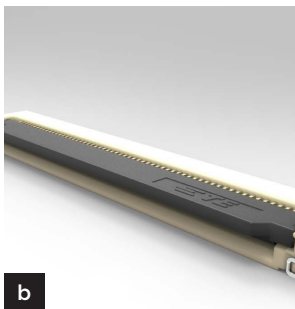
a



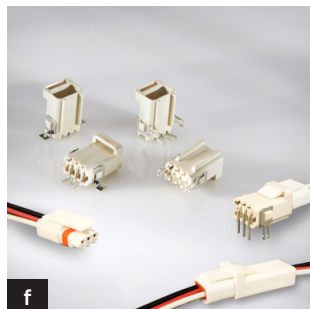
e



i



b



f



j

ソリッドステート ライティング

TE は、次世代の固定照明（SSL）ソリューションの開発分野に於ける業界のリーディングカンパニーです。屋外の照明器具から業務用冷蔵庫まで、新技術が照明分野の技術革新の推進のお手伝いをします。新規システムの創造、既存設計の強化等を問わず、TE は広範囲にわたって新しい省エネルギーソリューションを提供します。



a. [LUMAWISE Endurance S ドーム](#)

業界標準である Zhaga Book 18 に準拠し、過酷な環境での製品寿命を延ばします。IP65 と IP66 に適合し、直径 40mm と 80mm で提供されます。

b. [LUMAWISE Endurance S ベース、ベント付き](#)

業界標準である Zhaga Book 18 に準拠し、ベント機能で結露を最小限に抑えます。直径 80mm で提供され、防水型ベースアセンブリの内側の圧力均等化を実現しながらエンクロージャの防水性を維持します。

c. [LUMAWISE ドライブ LED ホルダータイプ Z50 DALI-2](#)

オンボードドライバ採用のソリューションにより、美観に優れた照明デザインを可能にします。Zhaga Book 12 の要件を満たし、スポット照明やトラック照明のドライバボックスが不要なため、照明デザイナーはより美しい照明ソリューションを実現できます。

d. [Corcom MRI LED 照明用 フィルタ](#)

価格志向型のスケラブルなオプションを用意しました。差動モードとコモンモードの両方のノイズを除去します。

e. [LUMAWISE Endurance N 短絡キャップ](#)

IP66 の防水性を備え、屋外照明のメンテナンスを減らし、動作寿命を延ばします。照明器具を過渡ライン電圧から保護します。

f. [ユニバーサルメイトロック ワイヤシールド](#)

コネクタハウジングに取り付け、防水性を実現します。AWG18 から AWG10 までのワイヤに対応し、ユニバーサルメイトロックコネクタを防水システムにアップグレードします。

g. [LUMAWISE ドライブ LED ホルダータイプ Z50 開発キット](#)

16 × 19mm、19 × 19mm、20 × 24mm、24 × 24mm の 4 つのサイズの CoB への熱および電気接続に対応します。350mA、500mA、700mA、1050mA の 4 つの電流出力に対応する LED ホルダーで、設計の柔軟性を高めます。

h. [Corcom FBL 照明用シリーズ](#)

標準 EMI 性能レベルが求められるアプリケーション向けで、これらのアプリケーションに対応する 10A および 20A バージョンでは、さらなる高電流を達成できます。300VAC が要求される照明アプリケーションでの使用を想定して設計されています。

i. [LUMAWISE Endurance N ベース、ベント付き](#)

フォトコントロールベースアセンブリは直径 76mm と 81mm で提供され、さまざまな高さのスリーブとカバーに対応します。ベースの周囲に一体化された「O」リングに

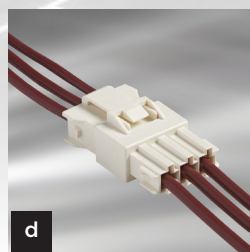
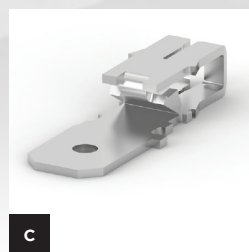
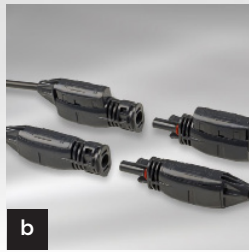
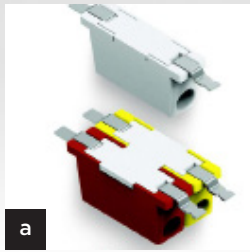
よるカバーとベースアセンブリのシールドは、IP66 等級に適合しています。

j. [小型 Push グリップワイヤ コネクタ](#)

ポークインワイヤ技術と工具不要の導体終端により、取り付け時間を短縮します。電圧試験用の試験スロットを装備し、工場や現場での簡易な取り付けを可能にします。

インテリジェント ビルディング

今日の建物はますます効率化され、建物にはさまざまなケーブル接続が使用されています。TE はお客様の複雑な接続に関する課題の解決をお手伝いすべく多くのソリューションを提供しています。弊社の新製品は、制御装置のシームレス統合を実現し、環境及び照明の制御から人の流れ、各種サービス機器に至る複数のビルシステム全体に電力とデータを確実に伝えることにより、より安全で確実な住居・作業空間を提供致します。



a. [BUCHANAN WireMate ITB](#) [モジュールポークイン](#)

使いやすいポークイン機能とワイヤ解放機能により、取り付け時間を短縮します。再利用やワイヤの交換に対応する優れた柔軟性を備えています。この低背型のコネクタの PCB のトップ表面からの高さはわずか 2mm で、水平方向のワイヤ挿入により、PCB 下のスペースの使用を最小限に抑えます。

b. [SOLARLOK 2.0](#) コネクタ

圧接 (IDC) 技術を使用した、工具不要の現場で取り付け可能な製品です。PV ケーブルから PV パネルにすばやく簡単に確実な接続を行えます。

c. [細線アルミニウムおよび銅マグネットワイヤに対応した MAG-MATE 端子](#)

AWG33 から AWG27 (0.18 ~ 0.36mm) のアルミニウムマグネットワイヤ、AWG34 から AWG28 (0.16 ~ 0.32mm) の銅マグネットワイヤに対応し、従来の MAG-MATE 端子では対応していなかった細線サイズのソリューションを提供します。

d. [多極マウント FASTIN-FASTON](#) [ハウジング](#)

3 つの同時接続が可能な 3 極ハウジングで、個々の接続を 3 回行う場合に比べ、組み立て工程を迅速化できます。大きな押圧面、丸みのある縁、折れ防止機構により、作業性を向上します。

e. [スロット ID 9 MAG-MATE 端子](#)

AWG25 から AWG24 (0.45 ~ 0.50mm) のアルミニウムマグネットワイヤ、AWG27 から AWG24 (0.38 ~ 0.50mm) の銅マグネットワイヤに対応し、従来の MAG-MATE 端子では対応していなかったワイヤサイズのソリューションを提供します。ワイヤストリップ技術により、マグネットワイヤの事前のワイヤストリップは必要ありません。

f. [パワートリプルロックヘッダ](#)

新しい単列のライトアングルおよび垂直ヘッダで、電線対基板オプションを拡大しました。接続の信頼性を高める 3 重のロック機構を提供します。

g. [BUCHANAN WireMate](#) [ツーピースポークインシリーズ](#)

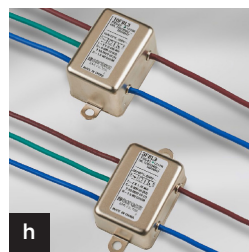
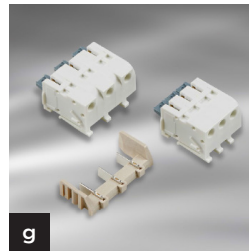
工具を必要としないポークイン電線の結線により、配線が簡単です。ワイヤマーキング用に平らなコネクタ表面を用意しました (カラーオプションあり)。

h. [Corcom FBL 照明用シリーズ](#)

標準 EMI 性能レベルが求められるアプリケーション向けで、これらのアプリケーションに対応する 10A および 20A バージョンでは、さらなる高電流を達成できます。300VAC が要求される照明アプリケーションでの使用を想定して設計されています。

i. [Standard FASTON](#) [リセクタクル端子、2D クリンプ付き](#)

低挿入力により、作業性を向上します。アプリケーションは 4 つの端子全てに標準対応し、何度もアプリケーションを交換することなく、生産性を高めます。



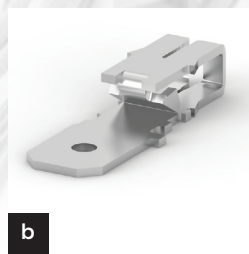
VA (高付加価値)

アセンブリ

システム間の接続性能は極めて重要です。弊社の専門知識、ノウハウによりお客様の設計の向上、効率化および費用の低減をお手伝いいたします。制御盤、電源システム、ケーブルアセンブリ、制御装置、タイマーまたはセンサを含む各種システム向けに、TE 製品は幅広いソリューションを提供します。



a



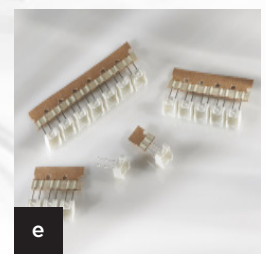
b



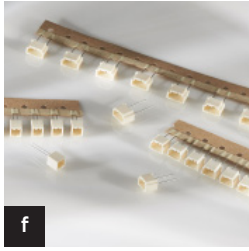
c



d



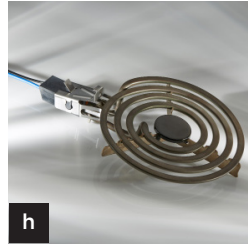
e



f



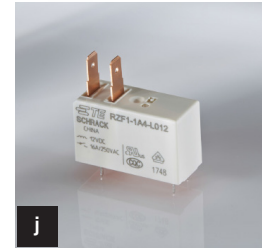
g



h



i



j

a. [BATTU 二層構造熱収縮チューブ](#)

過酷な環境の電力ケーブル対端子用途向けに設計された、接着層を持つ難燃性のチューブ製品です。ポリオレフィン製のジャケットと熱可塑性の内部接着層で構成され、優れた電気絶縁性、機械的保護、耐湿性を実現します。

b. [細線アルミニウムおよび銅マグネットワイヤに対応した MAG-MATE 端子](#)

AWG33 から AWG27 (0.18~0.36mm) のアルミニウムマグネットワイヤ、AWG34 から AWG28 (0.16~0.32mm) の銅マグネットワイヤに対応し、従来の MAG-MATE 端子では対応していなかった細線サイズのソリューションを提供します。

c. [4.8mm シリーズ FASTON リセプタクル](#)

厚さ 0.5mm または 0.8mm のタブと嵌合し、デザインイン、調達、組み立てが簡単になります。長さわずか 15mm のコンパクトサイズです。

d. [アルミニウムマグネットワイヤ向け AMPLIVAR スプライス](#)

最大 3 本のアルミニウムマグネットワイヤと 1 本の銅リードより線 (全体で 400~1500CMA) を 1 つのスプライスに同時に結線でき、効率的な接続を実現します。

e. [Economy Power 2.5 コネクタ](#)

端子ピッチが 2.5mm の小型コネクタです。オプションのダブルロックプレートで、最大 4.2A の定格を実現します (単列)。カチッという音で確実な嵌合を簡単に確認できます。

f. [GRACE INERTIA 2.5mm コネクタ](#)

組み立て中の人的ミスを減らします。慣性ロック機構により、半嵌合による製品の不具合を防ぎます。量産を行うメーカー向けにフラットパッケージタイプも用意されています。

g. [TPA 付きスタンダードパワータイマーハウジング](#)

さまざまなアプリケーションでプリント基板への一次電源供給をサポートします。それぞれ結線するよりも迅速に組み立てることが可能で、作業性の良いソリューションを実現します。

h. [表面マウント用コネクタシステム](#)

ハウジングの側面の保持用リブは、さまざまな構成のクリップに容易にはめ込むことができ、複数の設計要件に対応します。

i. [250 シリーズ Mini FASTON リセプタクル](#)

狭い空間に収まる、ミニチュアサイズのストレート構成を採用しました。標準的な 0.250 x 0.032 インチタブと嵌合します。

j. [RZF パワーリレー](#)

端子を含む基板上的取り付け高さがわずか 27.6mm の低背型設計で、端子を含まない高さは 17.9mm です。

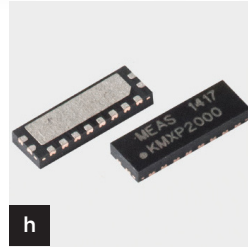
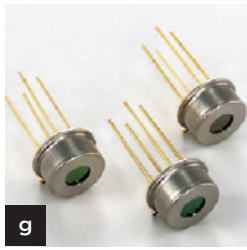
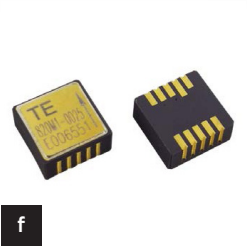
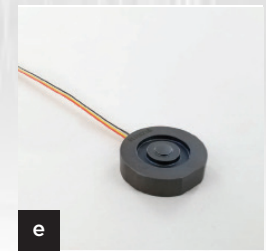
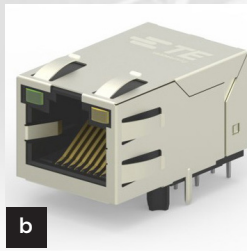
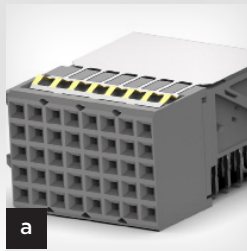
k. [Standard FASTON リセプタクル端子、2D クリンプ付き](#)

低挿入力により、作業性を向上します。アプリケーションは 4 つの端子全てに標準対応し、何度もアプリケーションを交換することなく、生産性を高めます。

ファクトリー

オートメーション

生産環境の自動化と分散化が進むにつれて、最小の接続さえもが実は欠かすことができない極めて重要な役割を担っています。TE は、生産のあらゆる箇所（回路基板のプロセスを最適化する各種機械から最も過酷な環境となる工場の現場）に於いて、電力を供給し、制御する革新的な接続ソリューションを提供します。



a. Z-PACK 2mm eHM コネクタ

CompactPCI Express 規格に準拠し、優れた電気的および機械的性能を低価格で実現します。

b. 一体型のマグネットと PoE を備えた Ethernet ジャック

260° C のリフローはんだ付けに対応し、製造を簡略化します。工程段階を追加する必要はありません。めっきに厚みを持たせることで、電気的問題と腐食を低減します。

c. Ethernet 用ディスクリット磁気製品

Ethernet インタフェースの設計の柔軟性を高め、最適化により、高い伝送特性と過電圧要件に対応します。260° C のリフローはんだに適合します。

d. AD-101 気泡検出器

超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流れの途切れ発生を確実に特定します。連続自己診断とパッケージの柔軟性により、クリティカルな用途向けの設計に対応します。

e. FX29 圧縮ロードセル

ミリボルト、増幅、デジタル出力のオプションを備え、設計の柔軟性と簡略化を実現します。信頼性の高い Microfused 技術を利用して、ミニチュアサイズで、10 ~ 100lbf (50 ~ 500N) の範囲に対応します。

f. 820M1 ボードマウント圧電

加速度計
広帯域幅と最大 10kHz を超える周波数応答を実現し、-40° C から +125° C の動作範囲でも出力ドリフトが発生せず、長期間安定して動作します。

g. デジタル熱電対列センサ

物理的な接触を介さず、低消費電流で温度を測定します。EMI 抵抗の改善と、低オフセット/低ノイズアンブ、関連フィルタなどの必要部品の削減により、設計の柔軟性を高めました。

h. KMX2P シリーズ AMR 位置センサ

PCB への垂直はんだ付けが可能な 3 つの新しい部品により、機械設計の選択肢を増やします。電子および機械サブアセンブリの設計の自由度を高めます。垂直とフラットはんだ付けの 2 つのバージョンで提供されます。

i. M12 PCB / パネルコネクタ (8/12 ピン)

高密度接続によるコンパクト設計、取り付けをすばやく簡単に行えるプラグアンドプレイ式により、PCB やパネルマウントを手早く確実に接続できます。

j. M12 パワー L コードパネルマウント PCB コネクタ

コンパクトなハイパワーソリューション向けに、標準的な M12 コネクタの 4 倍の電力を供給します。PNO は、PROFINET 規格への即時実装と配電ボックスの小型化の採用を承認しました。

データ コミュニケーション

世界を行き交う情報量が劇的に増加し、より高密度でより高速な通信に対応するデバイスとシステムに対するニーズが高まっています。TEはコネクタ及びケーブルのリーディングカンパニーとして、お客様の設計にお使いいただける製品を提供します。TEは、各種規格、プロトコル、シグナルコネクティブリティに関するノウハウ、データ通信に於ける接続にお使いいただける豊富な製品を取り揃えています。



a. Z-PACK 2mm eHM コネクタ

CompactPCI Express 規格に準拠し、優れた電気的および機械的性能を低価格で実現します。

b. スライディングパワーコネクタ

システム全体の電源を切らずに、サーバドロー内のコンポーネントのホットスワップが可能な他に類をみないコネクタで、システムダウンタイムに伴う多額のコストを節約できます。

c. Sliver SFF-TA-1002 コネクタ

SFF-TA-1002 の基準として採用され、EDSFF、PCIe、OCP NIC規格に対応し、断片化されたピン配列と速度の一体化により簡単なデザインを実現します。

d. マイクロ同軸リセプタクル

優れた電気性能を備え、幅広い用途で RF ケーブルアセンブリまたはアンテナをメイン PCB に接続します。

e. zSFP+ スタック式相互接続SFP56

最大 56Gbps PAM-4 のデータ転送速度を実現し、ハイパースケールデータセンタとネットワークスイッチ用途に対応する高フェースプレート密度を備えています。3列の両面基板用途に対応可能なスタック式で、密度を向上し、PCBスペースを最大限に節約します。

f. Sliver SFF-TA-1002 ストラドルマウントコネクタ

高速・高密度に対応した新しい標準となるフォームファクタを備え、シリコンおよびフェースプレートにプラグで接続可能な次世代のOCP NIC 3.0 アプリケーションに適合します。

g. ELCON Micro 電線対基板ソリューション

故意の誤嵌合を防ぐ設計であり、3.0mm の業界標準フットプリントでピンあたり最大 12.5A の高電流を提供します。

h. QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリ

既存の QSFP フォームファクタの密度を高め、最大 400Gbps の速度を実現し、次世代のデータセンタのニーズに対応します。

i. LGA 4189 ソケットおよびハードウェア

より高い性能、より優れたシステムスケーリングで、次世代の CPU を実現します。PCIe Gen 4、プロセッサを 4 基または 8 基搭載したシステムアーキテクチャに対応します。

j. Sliver プラグキット

リードタイムの短縮とコストの削減により、ハイスピードインターナル I/O マーケットへのすばやい参入が可能です。

k. 124 極 Sliver コネクタおよびケーブルアセンブリ

x16 PCIe から PCIe Gen 5、Ethernet 56G まで、さまざまなプロトコルに対応します。50 極コネクタと 74 極コネクタを別々に使用する必要はありません。

l. QSFP プラグプル I/O コネクタおよびケーシング

400Gbps までの総合データ速度をサポートします。優れた熱性能およびシグナルインテグリティ性能を備えています。

m. 高密度 + カードエッジパワーコネクタ

15A/2.54mm という市場最高クラスの高電流密度を備えたカードエッジコネクタです。データセンタ機器用の 2,000 ~ 3,000W 電源に対応します。

n. SFP56 および QSFP56 ケーブルアセンブリ

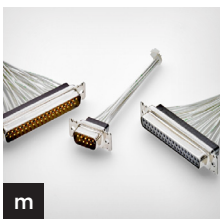
200Gbps までの総合データ速度をサポートします。最適化された構造により、挿入損失とクロストークを最小限に抑えます。

o. 48V バスバーコネクタおよびケーブルアセンブリ

Open Rack Standard V2.0 に対応したコネクタおよびケーブルアセンブリは、ラック内で使用できる単一の垂直バスバーにより、システム全体のコストを削減します。

過酷な 環境向けソリューション

これまでにない過酷な環境下での電子部品の使用が求められています。TE の新製品は、お客様がこうしたニーズにお応えし、振動、湿気、粉塵、紫外線等に 対応する製品を提供します。



a. MULTIGIG RT 2-S および RT 3 コネクタ
次世代の軽量かつ堅牢な高速バックプレーンコネクタで、25Gbps 超までの帯域幅に対応します。VITA 46 VPX コネクタのインタフェース寸法に適合しています。

b. Raychem CANbus ケーブル
堅牢な構造で、ほとんどの過酷な環境への暴露に耐えられます。最大 1Mbps の速度に対応します。J1939 の要件に準拠し、テープラップ仕様と比べて終端処理が簡単です。

c. スプリットバンディングリング
網組ソックや個々のまたは組み合わせたスクリーン網組の終端処理をバックシェルから離して行う必要がある場合に、軽量、堅牢、確実な終端を実現します。

d. HARTMAN スマート電流センサ
システムの現在のステータスとトリップステータスの両方を提供し、温度範囲全体でトリップ曲線を維持できます。必要に応じて、トリップ曲線を無効にすることもできます。

e. KILOVAC EV600 高電圧コンタクタ
双方向パワースイッチングと高い破断強度を備えた堅牢な 600A コンタクタです。過酷な環境向けに設計され、高い連続電流容量を備えています。



f. 鉄道用 M12 X コード直角コネクタ
嵌合時の高さが非常に低く (42.5mm)、限定された空間で直角コネクタを使用することにより、スペースを節約できます。ジャケットクリップ方式でケーブル破損を低減し、サービスコストを削減します。

g. CII FC-335 シリーズリレー
ハーメチックシールされたコンパクトな非ラッチ型リレーです。ほとんどの標準的な M83536 リレーを上回る容量定格を備え、機械ライフサイクルは 50,000 を上回ります。

h. Rayaten シールド付き INSTALITE モールド成形ブーツ
EMI 性能を強化し、ハーネス編組からバックシェルまでの EMI 導通を実現します。ほとんどの丸形コネクタとバックシェルに適合する汎用ブーツです。

i. DEUTSCH DMC-MD シールドケーブルクランプ
コンパクトで使いやすく、取り付けが簡単な 2 ピースのスプリットシェル設計です。2 つが同一形状になっているため、嵌合性の心配はありません。

j. NanoRF モジュールおよびコンタクト
バックプレーン側のフローティングインサートにより、接続前に RF コンタクトの位置を調整します。小型のコンタクトとさらに高い RF コンタクト密度で、パッケージの小型化を実現できます。

k. Raychem Cat 5e ケーブル
高性能、高耐久性、軽量性、信頼性を備え、高速データ通信に不可欠な最大 1Gbps のデータ速度に対応できます。

l. CII FCC-360 シリーズコンタクタ
小型、軽量の環境的に密閉された 60A コンタクタです。ダブルメーク接点設計により、すばやく確実な切り替えが可能です。

m. AMPLIMITE ステンレス鋼製 D サブミニチュアコネクタ
有害なカドミウムめっきを使用せずに、不動態化ステンレス鋼製の高耐久性ハウジングで 500 時間の耐塩水噴霧性を実現します。

n. M12 コネクティビティを備えたイーサネットスイッチ
最大 1Gbps のデータ速度をサポートし、将来のネットワーク機能の拡張にも対応します。オプションの Power over Ethernet (PoE) では電源ケーブルを別に用意する必要がなく、コストを節約できます。

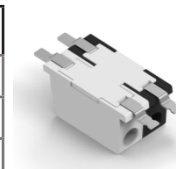
インダストリー 4.0：次の産業革命を加速

世界中の産業設備、オフショアプラットフォームで、複雑な製造工程を自動化、統合する大胆な構想が具体化しています。メーカーは、柔軟性を高め、効率化を進め、予期せぬダウンタイムを防ぎ、生産を高速化するデジタル技術の統合に期待しており、その期待はますます高まっています。インダストリー 4.0 と呼ばれるこの革命の中心にあるのは、相互運用性、つまり信頼できるマシンツーマシン (M2M) 機能、製造工程のディープラーニング、さらにはロボティックシステム、無人搬送車 (AGV) を含む革新的な技術のコントロールの強化を実現することにより、顧客価値を生み出す機会です。

新製品：

型番詳細	型番
BUCHANAN WireMate ITB モジュールポークイン	8-2834334-2
M12 A コードオス R/A- メス R/A ケーブルアセンブリ	T4162224005-005
M8 メスライトアングルシングルエンドケーブルアセンブリ	T4051420003-001
GNSS GPS および GLONASS SMD アンテナ	2118900-1
ケージアセンブリ 1X6 QSFP DD HS EXTRUSION SAN	2342891-2
リセプタクルコネクタ R/A SMT 76 POSN QSFP D	2318579-1

詳細：



[BUCHANAN WireMate ITB モジュールポークイン - 8-2834334-2](#)



[M12 A コードオス R/A- メス R/A ケーブルアセンブリ - T4162224005-005](#)



[M8 メスライトアングルシングルエンドケーブルアセンブリ - T4051420003-001](#)



[GNSS アンテナ - GPS/GLONASS、PCB、サーフェスマウント - 2118900-1](#)



[ケージアセンブリ 1X6 QSFP DD HS EXTRUSION SAN - 2342891-2](#)



[リセプタクルコネクタ R/A SMT 76 POSN QSFP D - 2318579-1](#)

製品システムを統合：

- メーカーは、弊社の幅広いソリューションにより、プラットフォームでデータを共有できる工場の機械やオフショア機器の操作、保守の必要性の予測、複雑で繰り返し可能な工程の自動化、常時接続のオンデマンドオペレーションの連携を行い、大量生産施設をカスタマイズされた製造工場に、海底プラットフォームをリアルタイムの探査・製造ネットワークに変えることができます。
- 工業生産における自動化、安全性、エネルギー効率の重要性はますます高まっています。TE は、お客様と連携して、製造工程のあらゆる面に対応したソリューションを開発し、これらの要件を満たします。TE は、私たちの生活のあらゆる面で、電力、データ、信号をつなぎ、その流れを保護するソリューションを設計、製造しています。

革新的ソリューション

新規のシステム設計、既存設計の強化等を問わず、TEは電気機械部品および電子部品の課題に対するソリューションを提供します。



端子&スプライス

コスト削減と生産性の向上に貢献する端子とスプライス



ドローン

最先端のドローン技術



リレー

アプリケーションの信頼性と生産性の向上に貢献



スマートホーム

スマートホーム用途のビジョンを実現



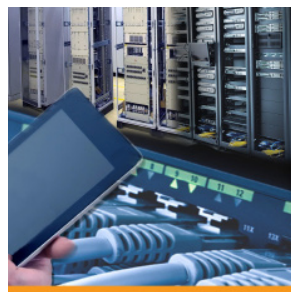
パワー

TEの豊富なパワー製品で設計ソリューションを促進



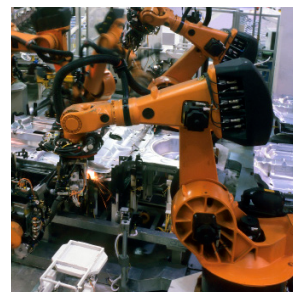
ウェアラブルデバイス

ウェアラブルデバイスのエンドツーエンドの接続性



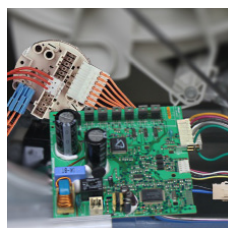
コミュニケーション I/O

さまざまな市場のニーズに適合し、寸法やデータレート等の課題の解決をお手伝い



モーション&ドライブ

システムの信頼性を高めると同時に、動力をセーブして費用の削減に貢献



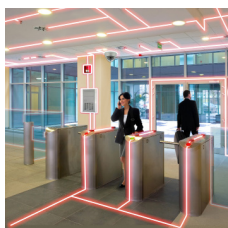
サブシステム設計

主要産業の最終製品をサポート



インダストリアルコントロール

迅速に設置可能且つお客様にご評価いただいている高信頼性を有する製品



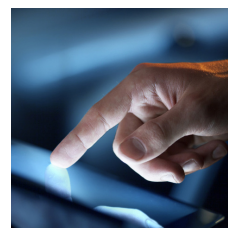
ビルディングセーフティ&セキュリティ

日々深化するインテリジェントビルのトレンドを先取り



マテリアルハンドリング

システムのメンテナンス時間を抑え、ダウンタイムを短縮



ポータブル&ハンドヘルドデバイス

より速いデータ速度、強化された保護、より小さいパッケージングにスムーズに移行



© 2019 TE Connectivity Ltd. family of companies.
 本文書に関する権利はすべて TE Connectivity に帰属します。

1-1773840-2 CM PL 10/2019 Rev 7

INSTALITE, DEUTSCH, ELCON, Corcom, FASTON, LUMAWISE, BUCHANAN
 WireMate, POWER TRIPLE LOCK, AMPLIVAR, GRACE INERTIA, MAG-MATE,
 Raychem, MULTIGIG RT, HARTMAN, KILOVAC, Z-PACK, SOLARLOK, TE
 Connectivity および TE connectivity (ロゴ) は商標です。ZQSFP+ および zSFP+ は
 ZXP[®] コネクタファミリーの一部で、ZXP 技術を使用しています。ZXP は Molex, LLC. の
 商標です。

本書で言及したその他のロゴ、製品および会社名は各社の商標である場合があります。

TE Connectivity は、本カタログに正確な情報を記載するべく可能な限りの努力を払っておりますが、情報に間違いがない
 ことを保証するものではなく、また、情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明したり保証す
 るものでもありません。本カタログに記載されている製品情報は、参照用のものであり、予告なく変更されることがあります。
 これらの変更・更新により生じた、いかなる付随的、派生的または間接的な損害に関しても、当社は責任を負いかねます。
 最新の寸法や設計上の仕様については、当社営業部までお問い合わせください。

